

**Preliminary Amendment**

Applicant: Michael Bauer et al.

Serial No.: Unknown

(Priority Application No. 10 2004 025 279.3)

(International Application No. PCT/DE2005/000892)

Filed: Herewith

(Priority Date: 19 May 2004)

(International Filing Date: 17 May 2005)

Docket No. I431.145.101/FIN 606 PCT

Title: SUPPORT WITH SOLDER BALL ELEMENTS AND A METHOD FOR  
POPULATING SUBSTRATES WITH SOLDER BALLS

---

**IN THE CLAIMS**

Please cancel claims 2-18 without prejudice.

1. Träger mit Lotkugelementen (1) für ein Bestücken von Substraten (2) mit Kugelkontakten (3), wobei der Träger (4) folgende Merkmale aufweist:
  - eine einseitig aufgebrachte Klebstoffschicht (5), wobei die Klebstoffschicht (5) einen Thermoplast oder Duroplast aufweist, dessen Adhäsionskraft bei Bestrahlung vermindert ist;
  - Lotkugelemente (1), die dichtgepackt in Zeilen (6) und Spalten (7) auf der Klebstoffschicht (5) in vorgegebener minimalzulässiger Schrittweite (w) für einen Halbleiterchip (8) oder rein Halbleiterbauteil (9) angeordnet sind.

2-18. (Cancelled)